

第1回 砥粒加工学会 アフタヌーンセミナー

半導体・機能薄膜 デバイス研磨技術の 最新動向

【主催】(公社)砥粒加工学会企画委員会

砥粒加工学会では、加工プロセスの最新動向を発信する新たな企画として「アフタヌーン（イブニング）セミナー」をスタートします。今回はその第1回として「半導体・機能薄膜デバイス研磨技術の最新動向」と題したセミナーを企画しました。半導体は今何かと話題に挙がる非常に注目度の高い材料ですが、その研磨（平坦化）の難易度の高さは皆様の知るところとなっています。本セミナーではこの半導体デバイスの研磨技術に焦点をあて、3つのユニークなプロセスについてご紹介します。今ホットな半導体の表面創成に関して、現行の半導体デバイスをはじめ、スピントロニクスデバイスとしても注目される機能薄膜の研磨技術に関する最新動向を知る貴重な機会です。皆様方の多数の聴講をお待ちしております。

◆日時： 2022年6月24日（金） 15時00分～17時35分（14時30分より受付開始）

◆開催方法： オンライン開催（WebEx） ※URL等の詳細はお申込み後に別途送付致します。

◆内容：

15:00～15:05 開催の挨拶 (公社)砥粒加工学会 企画委員長 水谷 正義

15:05～15:55 窒化ガリウムウエハの紫外線援用高効率・低ダメージ加工

パナソニックホールディングス株式会社 マニュファクチャリングイノベーション本部
マニュファクチャリングソリューションセンター 開発企画部 部長 鷹巣 良史 氏

15:55～16:45 固体電解質を用いた機能性材料の電気化学的表面創成～単結晶SiC基板の研磨を中心に～

立命館大学理工学部機械工学科 准教授 村田 順二 氏

16:45～17:35 化学研磨による完全結晶表面の創製が導く物性劣化のない高品質極薄膜

大阪大学産業科学研究所 特任助教 大坂 藍 氏

◆参加費： 正会員・賛助会員 5,000円、非会員 8,000円、学生会員 3,000円。

◆内容：

◆申込先： 下記 URL よりお申し込みをお願い致します。

https://www.jsat.or.jp/AfternoonSeminar_220624

◆申込締切： 2022年6月13日（月）

◆注意事項：

- ・ 個人単位でお申込み下さい。
- ・ ご入金確認後、視聴の URL をお送り致します。
直前のご入金の場合、URL のご連絡が間に合わない場合がございますのでご了承ください。
- ・ 講習会の静止画 / 動画撮影、録音は禁止です。
『レコーディング』ボタンで録音することは、法律で禁止されています。
- ・ 講演の音声、スライドの著作権は、発表者に帰属します。
テキストは当日出席者に電子データにて配布致します。

◆問合せ先： (公社)砥粒加工学会 〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-22-17 セラミックビル 4F

TEL: 03-3362-4195, FAX: 03-3368-0902, E-mail staff@jsat.or.jp